

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2006年1月5日 (05.01.2006)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2006/001422 A1(51) 国際特許分類⁷: B23K 35/30〒6691339 兵庫県三田市テクノパーク 12-6 三菱
マテリアル株式会社 三田工場内 Hyogo (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/011740

(22) 国際出願日: 2005年6月27日 (27.06.2005)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2004-189215 2004年6月28日 (28.06.2004) JP(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三菱マ
テリアル株式会社 (MITSUBISHI MATERIALS COR-
PORATION) [JP/JP]; 〒1008117 東京都千代田区大手
町一丁目5番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 石川 雅之
(ISHIKAWA, Masayuki) [JP/JP]; 〒6691339 兵庫県三
田市テクノパーク 12-6 三菱マテリアル株式会
社 三田工場内 Hyogo (JP). 小日向 正好 (KOHINATA,
Masayoshi) [JP/JP]; 〒6691339 兵庫県三田市テクノパ
ーク 12-6 三菱マテリアル株式会社 三田工場内
Hyogo (JP). 三島 昭史 (MISHIMA, Akihumi) [JP/JP];(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護
が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG,
BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR,
HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK,
LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,
MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU,
SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT,
TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護
が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA,
SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ,
BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE,
BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,
IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).添付公開書類:
— 国際調査報告書2文字コード及び他の略語については、定期発行される
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: Au-Sn ALLOY POWDER FOR SOLDER PASTE

(54) 発明の名称: はんだペースト用Au-Sn合金粉末

(57) Abstract: [PROBLEMS] To provide an Au-Sn alloy powder for use in producing an Au-Sn alloy solder paste reduced in the generation of voids. [MEANS FOR SOLVING PROBLEMS] An Au-Sn alloy powder for a solder paste, which has a chemical composition containing 20.5 to 23.5 mass % of Sn and the balanced amount of Au and inevitable impurities, and a structure wherein fine Sn-rich phases having a particle diameter of 3 μ m or less are crystallized in the base structure thereof in an amount of 0.5 to 30 area %.(57) 要約: 【課題】ポイド発生が少ないAu-Sn合金はんだペーストを製造するために使用するAu-Sn合金
粉末を提供する。【解決手段】Sn: 20.5~23.5質量%を含有し、残りがAuおよび不可避不純物からな
る組成、並びに素地中に粒径: 3 μ m以下の微細なSnリッチ相が0.5~30面積%晶出している組織を有する
はんだペースト用Au-Sn合金粉末。